



株式会社精工技研
事業本部
グローバル精機事業推進部

第1回 高機能プラスチック展(プラスチック ジャパン)に出展します

当社は、平成 24 年 4 月 11 日(水)~4 月 13 日(金)に東京ビッグサイトにおいて開催される『第 1 回 高機能プラスチック展(プラスチック ジャパン)』(主催:リード エグジビジョン ジャパン株式会社)にブースを出展いたします。

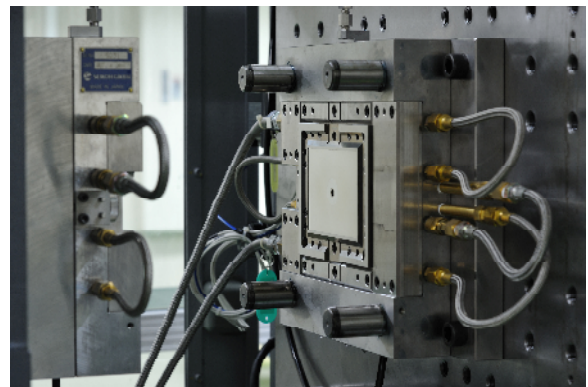
精密金型設計・製造ノウハウをベースに、光ディスク成形用金型で世界トップクラスのシェアを誇る当社は、今回の展示会では、低型温成形技術、微細転写技術、薄肉成形技術、単結晶 SiC 研磨技術等の新しい技術をご紹介します。これらの技術を光ディスク金型以外の精密金型設計・製造、及び成形に展開致します。

■ 低型温成形技術

金型内のキャビティ部に特殊処理を施した熱伝導率の低い素材を使用し、低型温での成形を可能とします。

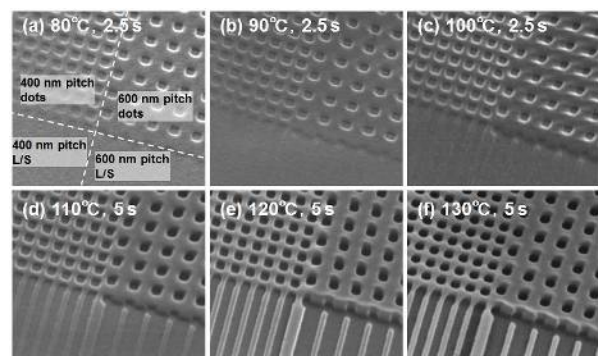
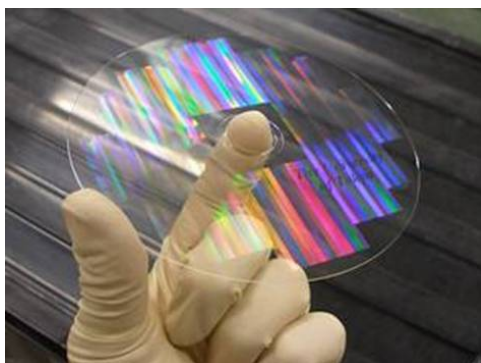
≫ 導入効果

- ・ 成形サイクルを大幅に短縮
- ・ 外観品質改善による成形品の歩留まりを向上
- ・ バリを除去する作業工程を削減
- ・ ガス発生減による金型のメンテナンスコストを削減



■ 微細転写技術

射出圧縮成形用金型を用いて、ナノレベルの微細な凹凸(高アスペクト比)を高精度に転写する技術を開発しました。次世代の医療・バイオ分野や光学分野の製品に期待される技術です



■ 薄肉成形技術

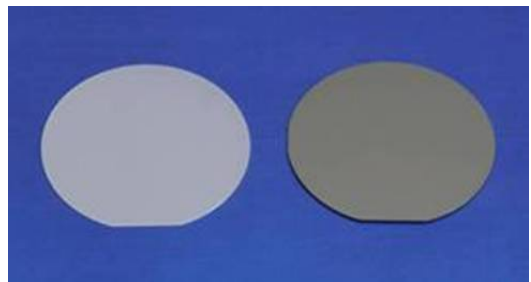
射出圧縮成形用金型と低型温成形技術の併用で、プラスチック射出成形でφ120mm×0.3mm 厚を実現。反りの発生も抑え、従来は射出成形が不可能と考えられていた薄肉成形品の新たな製造方法を確立しました。

■ 単結晶 SiC 研磨技術

金属材料の精密研磨加工技術に産業技術総合研究所の研磨技術を導入し、SiC(炭化ケイ素)結晶の研磨技術を確立。SiC 以外に GaN(窒化ガリウム)やサファイヤ等への応用も可能です。

≫ 導入効果

- ・ 加工に伴う結晶の歪みを大幅に低減
- ・ 研磨面の表面粗さ(Ra 値)は 0.1nm 以下
- ・ 研磨時間を短縮し、量産効率を向上



当社は、精密金型・精密加工をベースとする総合エンジニアリングメーカーとして、複雑な成形品の量産化や歩留まりの向上、成形サイクルの短縮等、お客様の要望に最適な解でお応えします。

ご相談やお問い合わせは下記までお気軽にご連絡ください。

株式会社 精工技研

事業本部 グローバル精機事業推進部 精機営業課

電話 : 047-386-3111

FAX : 047-388-4477

URL : <http://www.seikoh-giken.co.jp/>

E-mail : sales.mold@seikoh-giken.co.jp

以上